

SEMICON®

Japan2013 12/4 ▶ 6 幕張メッセ
WED FRI

Booth Number **5A-307**

Okamoto

セミコンジャパン2013 出展のご案内

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配賜り、有り難く厚くお礼申し上げます。

さて、今年も幕張メッセにてセミコンジャパン2013が開催されます。

弊社はTSV、グリーンデバイス、MEMS及びパッケージ向けの加工技術と薄厚化装置を紹介いたします。

ご多忙中誠に恐縮ではございますが弊社小間にご来場賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

平成25年11月吉日

株式会社岡本工作機械製作所

代表取締役社長 西本 實男

出展内容

- **TSV** Cuコンタミネーション対策新プロセスと最新装置
- **グリーンデバイス** 低ダメージ、高速加工技術と装置
- **MEMS** 高精度、チップングレス加工技術
- **パッケージ** 樹脂及び金属の同時研削加工技術
- **大型材料** ガラス、セラミック等の大型材料加工装置

Okamoto

SEMICON JAPAN 2013 Information

To all our valued customers. Hope you are doing well. We are participating Semicon Japan 2013 at Makuhari Messe, Tokyo. We are introducing the following at this show:

1. TSV process and machine
2. Green devices
3. MEMS and packages processing

Everyone at Okamoto is looking forward to your visit.

BEST REGARDS

OKAMOTO Machine tool works, LTD.

Chairman Jitsuo Nishimoto

Exhibits

- TSV Process** Cu contamination prevention, new process and latest machine.
- Green devices process** Low damage and high speed process and machine
- MEMS** High accuracy and chipping less process
- Packages** Simultaneous grinding and polishing of resin and metal material
- Large size** Glass, ceramics and special material processing technology for extra large work pieces